证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2022-050

苏州金宏气体股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 26 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“年充装 392.2 万瓶工业气体项目”予以结项,并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕941 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)12,108.34 万股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 15.48 元,募集资金总额为人民币 187,437.10 万元。扣除发行费用人民币 11,486.04 万元后,公司本次募集资金净额为人民币 175,951.06 万元。截至 2020 年 6 月 11 日,上述募集资金已全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2020 年 6 月 11 日出具了“容诚验字[2020]230Z0085 号”的《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已对募集资金实施专户存储管理,并与保荐机构招商证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司相城支行、浙商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容请见公司于 2020 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额	预计达到可使用状态日期
1	张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目	21,000.00	20,645.44	2021 年 12 月
2	苏州金宏气体股份有限公司研发中心项目	3,202.30	2,939.66	2021 年 12 月
3	年充装 392.2 万瓶工业气体项目	6,894.10	6,872.28	2021 年 12 月
4	年充装 125 万瓶工业气体项目	5,408.20	5,278.21	2021 年 12 月
5	智能化运营项目	11,551.30	4,042.31	2021 年 12 月
6	发展与科技储备资金	60,000.00	60,000.00	/
7	合计	108,055.90	99,777.90	/

公司于 2022 年 1 月 26 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州金宏气体股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-016)。

公司于 2022 年 1 月 26 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“年充装 392.2 万瓶工业气体项目”予以结项,并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)对本事项出具了明确的核查意见。

本次变更事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

原项目经公司 2019 年 11 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议批准,主要用于新产品的研发及生产、新生产基地建设、并购及补充营运资金等。原项目计划总投资额为 60,142.84 万元,拟使用募集资金金额为 60,000.00 万元,具体项目投资金额及构成如下:

序号	投资类别	投资金额(万元)	投资占比(%)
1	新产品研发项目	3,300.00	5.49
2	新生产基地项目	37,842.84	62.92
3	并购项目	10,000.00	16.63
4	补充营运资金	9,000.00	14.96
项目总投资合计		60,142.84	100.00

截止 2022 年 7 月 15 日,原项目已使用募集资金 25,836.20 万元,结余募集资金 34,163.80 万元,均存放于公司在中国银行东桥支行及中信银行苏州木渎支行开立的募集资金专户中。

原项目募集资金使用及结余情况如下:

单位:万元

序号	投资类别	已投入募集资金	尚需支付尾款	结余募集资金
1	新产品研发项目	1,215.20	0.00	2,084.80
2	新生产基地项目	5,493.43	127.57	32,079.00
3	并购项目	10,000.00	0.00	0.00
4	补充营运资金	9,000.00	0.00	0.00
合计		25,708.63	127.57	34,163.80

(二)变更的具体原因

原项目的建设主要包括用于新产品的研发及生产【高纯三氟化氯、高纯三氟化硼、液态有机储氢技术、改性碳纤维脱硫剂】,新生产基地建设【年产 500 吨电子级氧化亚氮、500 吨电子级液氯项目、年产 1,680 吨电子专用材料项目(正硅酸乙酯)、年产 5,000 吨电子级氧化亚氮项目、年产 1,200 吨电子级溴化氢项目、年产 100 吨羰基硫项目】,并购及补充营运资金等,均与公司现有主要业务、核心技术密切相关,符合公司的发展目标和发展战略,是公司现有主要业务、核心技术的发展与补充。

截止 2021 年 12 月 31 日,原项目“新产品的研发及生产”中“高纯三氟化氯”、“高纯三氟化硼”、“液态有机储氢技术”及“改性碳纤维脱硫剂”均已经完成工艺包设计并结项。“新生产基地建设”中“年产 1,680 吨电子专用材料项目(正硅酸乙酯)”和“年产 5,000 吨电子级氧化亚氮项目”已完成竣工验收;“年产 500 吨电子级氧化氢、500 吨电子级液氯项目”因所在化工园区正在等待认定中,导致工程停滞;“年产 1,200 吨电子级溴化氢项目”和“年产 100 吨羰基硫项目”因所在化工园区尚未匹配具体地块,项目尚未开展。

综上,公司将将募集资金投资项目之一的“发展与科技储备资金”变更为“全椒金宏电子材料有限公司、北方集成电路技术创新中心大宗气站项目及广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目”。

三、新项目的具体内容

(一)项目内容及规模

1、全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目

新项目“全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目”实施主体全椒金宏电子材料有限公司(以下简称“全椒金宏”)为公司控股子公司,成立于 2022 年 01 月 19 日,注册资本 18,000.00 万元人民币,为专业从事电子专用材料制造及销售的企业。

新项目“全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目”总占地面积约 42 亩,建筑面积约 5000 平方,项目内容包括建设厂房设施【办公楼、公用工程车间、化验室、生产厂房、甲类仓库等配套安全设施】,生产装置【合成反应器、蒸馏塔、再沸器、冷凝器、成品罐、尾气处理装置、罐装系统】及配套的共用工程【循环水、冰水机组(冷冻水系统)、氮气、氧气、导热油或热水循环系统、洗眼器(喷淋系统)、消防、监控(安防)、雨水系统、污水系统等工艺生产配套系统、事故水池等】。项目建设完成后,将形成年产 10 吨乙硅烷和年产 10 吨三甲基硅胺生产线。

新项目“全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目”总投资 19,000.00 万元,其中,建设投资 18,000.00 万元,铺底流动资金 1,000.00 万元。具体项目投资金额及构成如下:

序号	投资类别	投资金额(万元)	投资占比(%)
1	建设投资	18,000.00	94.74%
1.1	工程费用	5,900.00	31.05%
1.1.1	建筑工程费	4,400.00	23.16%
1.1.2	设备购置费	600.00	3.16%
1.1.3	安装工程费	900.00	4.74%
1.2	工程建设其他费用	11,800.00	62.11%
1.3	基本预备费	300.00	1.58%
2	铺底流动资金	1,000.00	5.26%
项目总投资合计		19,000.00	100.00

项目建设期共计 18 个月,预计 2024 年达到使用状态。

2、北方集成电路技术创新中心大宗气站项目

新项目“北方集成电路技术创新中心大宗气站项目”实施主体北京金宏电子材料有限责任公司(以下简称“北京金宏”)为公司全资子公司,成立于 2021 年 12 月 08 日,注册资本 6,000.00 万元人民币,主要为北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司提供氮气(GN2 及 PN2)、氢气(PH2)、氧气(PO2 及 IO2)、氩气(PAr)、氦气(PHe)、二氧化碳(PCO2)、压缩空气(CDA)、仪表空气(IA)及高压压缩空气(XCDA)等电子大宗气体。

新项目“北方集成电路技术创新中心大宗气站项目”总占地面积 1887.84 平方米,地上建筑面积 944.55 平方米,项目内容包括建设综合厂房(含空压机房、纯化间、配电室、消防泵房等)、氢气纯化间和供氢站以及露天制氮区和低温罐区。

新项目“北方集成电路技术创新中心大宗气站项目”总投资 25,000.00 万元,其中,建设投资 24,300 万元,流动资金 700 万元。具体项目投资金额及构成如下:

序号	投资类别	投资金额(万元)	投资占比(%)
1	建设投资	24,300	97.20
1.1	工程费用	23,300	93.20
1.1.1	建筑工程费	3,000	12.00
1.1.2	设备购置费	16,000	64.00
1.1.3	安装工程费	4,300	17.20
1.2	工程建设其他费用	500	2.00
1.3	基本预备费	500	2.00
2	铺底流动资金	700	2.80
项目总投资合计		25,000.00	100.00

项目建设期共计 12 个月,预计 2023 年达到使用状态。

3、广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目

新项目“广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目”实施主体广州金宏电子材料科技有限公司(以下简称“广州金宏”)为公司全资子公司,成立于 2022 年 05 月 27 日,注册资本 4,000.00 万元人民币,主要为广东芯粤能半导体有限公司提供一般氮气(GN2)、高纯氮气(PN2)、普通氧气(GO2)、高纯氧(PO2)、氢气(PAr)、氢气(PH2)、氦气(PHe)、二氧化碳(PCO2)、压缩空气(CDA)和高压压缩空气(HPCDA)等电子大宗气体。

新项目“广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目”拟租赁广东芯粤能半导体限公司厂内土地 4393.1 平方米,建设高纯氮气 3000Nm3/h、一般氮气 5100Nm3/h、高纯氧气 48Nm3/h、一般氧气 72Nm3/h、高纯氢气 60Nm3/h、高纯氢气 108Nm3/h、高纯氦气 18Nm3/h、压缩空气 CDA9600Nm3/h 大宗气站一座。

新项目“广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目”总投资 15,000.00 万元,其中,建设投资 13,786.00 万元,铺底流动资金 1,214.00 万元。具体项目投资金额及构成如下:

序号	投资类别	投资金额(万元)	投资占比(%)
1	建设投资	13,786.00	91.91
1.1	工程费用	12,986.00	86.57
1.1.1	建筑工程费	1,000.00	6.67
1.1.2	设备购置费	9,300.00	62.00
1.1.3	安装工程费	2,686.00	19.24
1.2	工程建设其他费用	400.00	2.67
1.3	基本预备费	400.00	2.67
2	铺底流动资金	1,214.00	8.09
项目总投资合计		15,000.00	100.00

项目建设期共计 12 个月,预计 2023 年达到使用状态。

综上,新项目总投资合计 59,000.00 万元,拟使用募集资金 34,163.80 万元,项目投资总额与募集资金使用金额之间的差额公司将以自筹资金补足,具体如下:

序号	投资类别	备案金额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目	19,000.00	12,000.00
2	北方集成电路技术创新中心大宗气站项目	25,000.00	15,163.80
3	广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目	15,000.00	7,000.00
合 计		59,000.00	34,163.80

(二)新项目可行性

新项目是公司提高市场竞争力和可持续发展的重要战略举措,有着非常优越的技术优势和市场条件。

1、新项目的建设,有助于公司抢占市场先机,提升市场占有率。

随着半导体集成电路技术的发展,对电子气体的纯度和质量也提出了越来越高的要求。电子气体的纯度每提升一个数量级,对下游集成电路行业都会产生巨大影响。2014 年国家发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》并设立了集成电路产业投资基金,根据规划,我国集成电路销售额年均增速将保持在 20%左右,预计 2020 年将达到 8700 亿元。若半导体用电子气体保持同样稳定的增速,国内半导体用电子气体市场将在 2020 年翻番。

新项目建成后,将形成年产 20 吨半导体先进制程前驱体(三甲基硅胺和乙硅烷)及氮气(GN2 及 PN2)、氢气(PH2)、氧气(PO2 及 IO2)、氩气(PAr)、氦气(PHe)、二氧化碳(PCO2)、压缩空气(CDA)、仪表空气(IA)及高压压缩空气(HPCDA)、高纯压缩空气(XCDA)等电子大宗气体。有助于公司抢占市场先机,同时能够在一定程度上提升市场占有率。

2、新项目的建设,是公司战略布局的需要,符合企业未来发展方向。

公司坚持纵横发展战略,以科技为主导,定位于综合气体服务商,为客户提供创新和可持续的气体解决方案,成为气体行业的领跑者。

新项目的建设,有助于公司加快研制替代进口的电子特种气体及前驱体材料,突破我国在半导体产业链建设的瓶颈,打造行业先锋。

新项目的建设,标志着公司成为国内供应电子大宗气体的少数供应商,将大力推进该领域国产替代;证明了公司通过电子特气业务进入电子大宗气业务战略获得成果,证明了公司在电子大宗气方面领先的资源和实力,开启了公司电子大宗气体这一蓝广的新业务领域。

新项目的建设,将进一步提升公司的竞争优势,是公司战略布局的重又一环,符合公司未来发展方向。

3、本项目的建设,符合相关产业政策的要求。

新项目采用国内自主开发、先进的技术和设备,项目符合国家有关产业政策,并满足国家和地方的环保要求,充分利用当地资源优势,生产成本低,产品目标市场稳定,保证了项目的效益。具有较强的市场竞争力,对于推动当地资源循环经济可持续发展,环境治理保护等方面都具有重要意义。

(三)募集资金管理计划

相关审批程序履行完成后,公司将根据募投项目的实施进度,逐步投入募投资金,并对募投项目实施单独建账核算,以提高募集资金的使用效率。

为确保募集资金使用安全,全椒金宏、北京金宏及广州金宏将开立募集资金存放专用账户,并与公司以及存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议,严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定实施监管监督,公司也会根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)新项目市场分析

新项目为电子专用材料的开发与生产,随着半导体集成电路技术的发展,对电子气体的纯度和质量也提出了越来越高的要求。电子气体的纯度每提升一个数量级,对下游集成电路行业都会产生巨大影响。2014 年国家发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》并设立了集成电路产业投资基金,根据规划,我国集成电路销售额年均增速将保持在 20%左右,预计 2020 年将达到 8700 亿元。若半导体用电子气体保持同样稳定的增速,国内半导体用电子气体市场将在 2020 年翻番。

新项目建成后,将形成年产 20 吨半导体先进制程前驱体(SGA 和乙硅烷)及氮气(GN2 及 PN2)、氢气(PH2)、氧气(PO2 及 IO2)、氩气(PAr)、氦气(PHe)、二氧化碳(PCO2)、压缩空气(CDA)、仪表空气(IA)及高压压缩空气(HPCDA)、高纯压缩空气(XCDA)等电子大宗气体。有助于公司抢占市场先机,同时能够在一定程度上提升市场占有率。